

GF300UT

双组份超薄导热凝胶

产品介绍

GF300UT 是一款导热率为 3W-mK 的双组份可固化液体有机硅超薄界面填充材料。该产品具有优异的导热性能和贴合性，能够在室温下固化，也可随温度升高加速固化。

GF300UT 拥有较低的粘度和出色的触变性，易于点涂、丝网印刷及模板印刷。不同于传统的导热凝胶产品，GF300UT 可以达到非常低的界面贴合厚度，因此具有较低的热阻，其综合热性能与导热硅脂相当。固化后该材料会形成低模量的弹性体并降低由于热膨胀系数差异所产生的应力挤压作用，从而有效防止 pump-out 现象发生。

特点

- 良好的润湿性能
- 极低的界面贴合厚度 (BLT) 及热阻
- 高导热率：3.0 W/m-K
- 优异的触变性能，易于点胶、丝网印刷及模板印刷
- 可固化形成低模量弹性体，避免 pump-out
- 长期使用稳定性及可靠性
- 可室温固化或高温快速固化

应用

- 汽车电子设备
- 移动电子设备
- 通讯领域
- IGBT 模块
- LED

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区
彩达三街1号茂华工场2号楼
T:8610-89475123
F:8610-89475077
BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 32082

性能

颜色/A 组份:	白色
颜色/B 组份:	灰色
密度:	3.0 g/cm ³
混合比例:	1:1
粘度 @Brookfield (Part A):	300,000cps
粘度 @Brookfield (Part B):	300,000cps

固化后性能

颜色:	灰色
硬度:	50 shore00
导热系数:	3.0 W/mK
热阻@50°C, 50psi:	0.02°C-in ² /W
典型最小界面贴合厚度:	0.035mm
温度范围:	-50°C ~ +200°C
阻燃等级:	UL-94V0

固化时间

操作时间 @ 25°C:	40 min
固化时间 @ 25°C:	18 hrs
固化时间 @ 100°C:	30 min

其他信息

GF300UT 为铂金催化体系，使用前与之接触的器件表面须清洁干净。一些特定的材料、化学品、固化剂及增塑剂与 GF300UT 接触会抑制，甚至使其铂金催化剂体系失效，继而造成固化反应不完全或无法进行，这类材料主要包括：

- 有机锡和其他有机金属化合物
- 含有锡类催化剂的有机硅橡胶

- 硫磺、多硫化物、聚砷或其它含硫材料
- 胺类、聚氨酯或含胺材料
- 不饱和碳氢增塑剂

应用指南

- GF300UT 含有少量的溶剂作为稀释组份以降低体系粘度从而利于丝网印刷或点涂。应用该材料于器件表面后，建议先将溶剂挥发再进行装配以达到最佳的散热性能。以应用厚度为 0.25mm 为例，室温下推荐溶剂挥发去除时间为 60min。实际的溶剂挥发时间还要根据客户应用材料的具体厚度及环境条件进行确定。
- 一旦 GF300UT 以丝网印刷或模板印刷的方式应用后，使用的相关印刷工具建议在 1.5 小时内使用溶剂诸如甲苯、乙醇、丙酮、异丙醇进行清洗。
- 该产品应确保在原包装内密封保存，否则因其内部包含的溶剂挥发会导致材料粘度上升，进而影响其应用。